# 溶胶 凝胶法制备掺铝氧化锌薄膜

韦美琴<sup>1</sup>,张光胜<sup>1</sup>,姚文杰<sup>2</sup>

(1. 安徽工程科技学院机械系,安徽 芜湖 241000; 2. 安徽省白湖阀门厂有限公司,安徽 巢湖 231508)

[摘 要] 采用溶胶 凝胶工艺在普通玻璃片上制备了掺铝氧化锌薄膜。通过 X射线衍射 (XRD)、原子力显微镜 (AM)对薄膜的组织结构和形貌进行了表征,结果表明:用溶胶 凝胶法制得的掺铝氧化锌薄膜为纤锌矿型结构,呈 c轴方向择优生长,表面均匀、致密。通过紫外 可见透射光谱 (UV)和标准四探针法对薄膜的光电性能进行了研究。试验发现,当铝离子掺杂浓度为 4% (摩尔分数)、溶胶物质的量浓度为 0.6mol/L、前处理温度为 300 时,薄膜在可见光区的透过率超过 80%,且具有较好的导电性,电阻率为 8.0 ×10<sup>-4</sup> · cm。

[关键词 ] 溶胶 凝胶法;铝离子掺杂; c轴择优取向;光电性能;氧化锌薄膜 [中图分类号] TB43 [文献标识码]A

[文章编号]1001 - 3660(2007)04 - 0034 - 03

## A lum inum -doped ZnO Thin Films by the Sol-Gel M ethod

WEIM ei-qin<sup>1</sup>, ZHANG Guang-sheng<sup>1</sup>, YAO W en-jie<sup>2</sup>

(1. School of Mechanical Engineering, Anhui University of Technology and Science, Wuhu 241000, China;

2. Anhui Baihu Valve Factory Limited Company, Chaohu 231508, China)

[Abstract] Al-doped ZnO thin films were fabricated on glass substrates by sol-gel method Their microstructures and morphologies were studied with X-ray diffraction (XRD) and atomic force microscopy (AFM). The results indicate that the thin films by the Sol-Gel method are c-axis orientation, homogeneous and dense surface with the crystalline structure of hexagonal wurtzite. U sing the measurement of UV-V is transmittance spectroscopy and standard four probes method, the electrical and optical properties of Al-doped ZnO thin films were investigated. The experimental data show that their optical transmittance are over 80% in visible region and their favorable electrical conducting has been achieved with resistivity of 8.0  $\times 10^{-4}$  · cm derived by Al/Zn ratios of 4.0%; sol concentration of 0. 6mol/L; re-heat treatment at 300 ; annealing at 500 .

[Key words] Sol-gel method; Al-doping; C-axis orientation; Electrical and optical properties; ZnO thin film

## 0 引 言

透明导电氧化物薄膜材料具有大的载流子浓度和光学禁带 宽度,因而表现出优良的光电特性,如低的电阻率和高的可见光 透过率等。目前主要应用于包括太阳能电池和平板显示器的透 明电极、电磁防护屏以及建筑玻璃的红外反射涂层等。掺杂 A1 的 ZnO (ZAO)薄膜,具有与 ITO 薄膜相比拟的对可见光的高透 过率和高电导性,而且具有材料来源丰富、价格低廉、热稳定性 高等优点。目前,ZAO 被认为是掺杂效果最好、极具开发潜力 的功能薄膜之一.已成为替代 ITO透明导电薄膜的研究热点。

所有能制备半导体材料的方法都能制备 ZAO薄膜,国内外 学者制备 ZAO薄膜的方法主要有:化学气相沉积法<sup>[1]</sup>、溶胶 凝 胶法<sup>[2]</sup>、脉冲激光法<sup>[3]</sup>、分子束外延法<sup>[4]</sup>以及射频磁控溅射和 反应磁控溅射法<sup>[56]</sup>。溶胶 凝胶工艺是一种新型高效的纳米材 料制备技术,用它制备纳米薄膜具有薄膜均匀性好、对衬底附着

[收稿日期]2007-03-29

[作者简介]韦美琴(1975-),女,安徽安庆人,硕士,从事材料表面工程的研究。

力强;易于精确控制组分的化学计量比和掺杂改性;适于大面积 制膜和批量生产;设备简单;成本低等优点。本文是以溶胶 凝 胶工艺在普通玻璃基片上制备出光电性能好的 ZAO薄膜。

## 1 试 验

#### 1.1 溶胶的制备

用天平称取一定量的二水合醋酸锌 Zn(CH<sub>3</sub>COO)<sub>2</sub> · 2H<sub>2</sub>O (前驱物)粉末,放入蒸馏瓶,再加入溶剂乙二醇甲醚蒸发回流, 加热搅拌约 30m in左右,将回流后的溶液放入容量瓶。再将适 量的硝酸铝放入无水乙醇中搅拌均匀,制成透明的溶液。将回 流后的溶液与等摩尔的乙醇胺 (DEA)在 60 水浴加热 1h,然后 与搅拌好的硝酸铝溶液混合并放入容量瓶中,再按需加入无水 乙醇、乙醇胺、甲酰胺 (CH<sub>3</sub>NO)等有机试剂,震荡均匀,配制出 溶胶。放置一定的时间待溶胶均匀稳定后使用。

#### 1.2 薄膜的制备

采用的基体材料是普通的玻璃片,在涂膜前先用 NaOH稀 溶液、重铬酸钾溶液浸泡清洗,再用去离子水、甲醛、丙酮和无水 乙醇在超声波中对基片进行清洗,干燥后备用。采用旋涂法镀 膜,首先必须设置好旋涂速度和旋涂时间,涂膜结束后立即放入 干燥箱中在 100 下对湿膜干燥 10m in,然后放入马弗炉中在 200~400 预处理 10m in,再进行第 2次镀膜。反复旋涂到所需 厚度后,放入马弗炉中在 400~600 下退火处理 1h,这样就制 备出性能较优的掺铝氧化锌薄膜。

## 1.3 薄膜的分析与测试

利用德国 BRUKER-AXS公司的 D8FOCUS型 X射线衍射仪 (CuK<sub>1</sub>)分析薄膜样品的晶相结构,用 <u>CSPM4000</u>原子力显微 镜分析薄膜表面的微观形貌,用 UN CO公司的 UN-2100型紫外 分光光度计测试薄膜的透射光谱。采用广州半导体材料研究所 生产的 XX-2型方块电阻仪测定薄膜的表面电阻。薄膜样品的 厚度是采用 AMB DS公司的 XP-1型台阶仪来测试的。

## 2 结果与讨论

#### 2.1 薄膜 X射线衍射 (XRD)分析

图 1为不同掺杂浓度下的 ZAO薄膜样品的 X射线衍射谱 图。在溶胶浓度、预处理温度和退火温度均相同的条件下,制备 出不同掺杂浓度的 ZAO薄膜样品。掺杂 AI的浓度分别为 2%、

#### 350 160 350 (002)140 300 300 (002)(002)(101) 120 250 250 (100)100 世 200 **油** 200 101 ΨN (100)80 閉150 國 150 (101)田 (100)60 100 100 40 50 50 20 0 0 0 20 30 40 20 30 50 60 70 20 30 40 50 60 70 80 50 60 40 80 2 0 /(°) 2 θ /(°) $2 \theta / (^{\circ})$ h 掺Al浓度4% a 掺Al浓度2% c 掺Al浓度6%

引起的。

### 图 1 不同掺 AI浓度下的 ZAO薄膜的 XRD谱

Figure 1 The XRD patterns of ZAO thin films with the various A1 doping concentrations

## 2.2 薄膜的表面形貌分析

利用原子力显微镜 (AFM)对薄膜样品的表面进行观察。 图 2为不同溶胶浓度的 ZAO薄膜的原子力显微镜照片。从图 中可看出,薄膜生长致密均匀、表面平整,薄膜的表面粗糙度 Ra (中心线平均粗糙度)分别为 17.831mm和 8 795mm,晶粒大小 都比较均匀。在相同的工艺条件下,浓度增大时,其晶粒呈增大 的趋势。从表面形貌整体来看,薄膜 c轴取向度最好的是浓度 为 0 6mol/L的样品,其结晶质量较好。





2

图 2 不同溶胶浓度的 ZAO薄膜的 AFM 图

Figure 2 The AFM images of ZAO thin films with different sol concentration 2 3 薄膜的光学性能分析

图 3为不同掺 AI浓度下 ZAO薄膜的透光率随波长变化的 特性曲线。由图可见,薄膜在可见光范围内具有高透光性,其平 均透光率大于 80%。随着掺 A1浓度的增加,透光率呈现出先 增加后减小的趋势。这是由于掺杂浓度越大,薄膜的结构缺陷 越多,结构越松散,薄膜的透光率减小。掺杂 A1的摩尔分数为 4%时,透光率较好。



图 3 不同掺 A l浓度的 ZAO薄膜透射光谱 Figure 3 Optical transmittance spectra of ZAO thin films with different A l doping concentrations

随着掺杂浓度的增加,吸收边向短波方向移动,即薄膜的截止波长和吸收边这一点"蓝移"。这种"蓝移现象可用基于 Burstein-Moss<sup>[7]</sup>效应所引起的能隙宽化效应加以解释。随着铝 掺杂浓度的增加,薄膜载流子浓度随之增加,而载流子的增加是 外部杂质掺入引起的替位所致,由于掺杂引起的载流子填充了 导带较低的能级,其结果使价带中的电子跃迁到导带中较高的

4%、6% (摩尔分数)。从图 1可以看出,所有的 ZAO薄膜样品

在 2 = 34, 442 附近存在着相应于 (002) 面的衍射峰, 且 (002)

晶面的衍射最强,表明制备出的 ZAO薄膜为 (002)择优取向纤

锌矿的 ZnO结构。随着掺杂浓度的增加,衍射峰呈现出先增强

后降低的趋势,半高宽也是先变窄后变宽。当掺 Al的摩尔分数 为 4%时,(002)晶面衍射峰的取向最明显,强度也最大。当掺

A1的摩尔分数大于 4%时,(002)峰的强度随着掺 A1浓度升高

而减弱,薄膜的结晶质量下降。这说明掺杂浓度的增加进一步

破坏了薄膜的晶体结构,从而削弱了(002)峰的强度。这是由

于 Zn离子和掺杂的 Al离子的尺寸不同所形成的应力引起的。

 $A\hat{l}^{+}$ 的半径 (0.054nm)比  $Zn^{2+}$ 的半径 (0.074nm)小,  $A\hat{l}^{+}$ 对

Zn<sup>2+</sup>的掺杂替代会造成晶格畸变,在结晶过程中会产生残余应

力,从而破坏了晶体的有序性。所以最佳的掺杂浓度为4%。 XRD测试的结果表明,在掺AI的 XRD中未发现硝酸铝的特征

峰,这是因为杂质含量小的原因。铝的掺杂并没有改变 ZnO的 晶体结构,而是取代了晶体结构中锌的位置,所沉积的 ZAO薄

膜中晶粒具有六角纤锌矿结构,呈 c轴择优取向,即晶粒垂直于

衬底方向柱状生长。另外,衍射图中有些杂峰是由于玻璃基片

35

能级,这样的电子跃迁所需要的能量就必然要大些。由于光子 的能量和光波的频率有关,频率低的光波的能量小,所以薄膜吸 收光子的波长限向短波方向移动就是带隙"增大"的缘故。由 于铝在 ZnO薄膜中的溶解度有限,当铝掺杂到一定程度时其载 流子浓度趋于饱和,吸收边的移动趋于一个极值,即吸收限的紫 外截止都处于同一位置。而掺杂浓度为 6%的薄膜的吸收限反 而在低掺杂浓度的长波方,是由于这时掺杂引起的薄膜的结构 变差已经比较严重了,定域态带尾大,所以带隙减小占了优势。

## 2.4 薄膜的电学性能分析

ZAO是透明导电氧化物半导体薄膜,具有相对开放式的晶体结构,它的所有八面体晶格位置和一半的四面体晶格位置是空余的,从而使外来掺杂原子能够进入 ZnO晶格。在 ZAO薄膜内,氧空位和替位掺杂是载流子的主要来源,即薄膜内的载流子主要来源于氧空位以 A<sup>31</sup>\*对 Zn<sup>2+</sup>的置换所提供的导电电子。

图 4为薄膜电阻率随退火温度变化的曲线图。从图中可以 看出,退火温度从低到高,样品的电阻率呈现先减小后增大的趋势。其中,退火温度在 500 时电阻率较小,其值为 & 0 ×10<sup>-4</sup>





Figure 4 Surface resistance of ZAO thin films with different anneal temperature 因为随着退火温度的提高,薄膜的结晶程度逐渐增加,而结 晶程度的提高会导致载流子迁移率增大,所以薄膜的电阻率就 降低;同时退火温度的提高会引起薄膜中氧空位浓度的增加,因 此就提高了薄膜中的载流子浓度,从而降低了薄膜的电阻率。 低温下制备的薄膜中存在较大的内应力,而热处理能减小薄膜 内应力的作用,有益于薄膜的晶粒垂直于基片生长,优化晶体结 构使薄膜导电性增强。

铝离子在 ZnO中取代锌离子位置后提供自由电子,当温度 刚开始增长时,可以增加载流子浓度,从而使电阻减小。但当温 度非常高时,铝很有可能脱水生成 A1<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 与 ZnO形成固溶体<sup>[8]</sup>,

(上接第 30页)

[参考文献]

- [1] 孙丽荣,王军,黄柏辉.导电胶粘剂的现状与进展 [J].中国胶粘剂,2004,13(3):60-63
- [2] 吴人洁.复合材料 [M].天津:天津大学出版社,2000.158-165
- [3] Shi F G, Abduuah M, Chungpaiboonpatana S, et al Electrical conduction of nisotropic conductive adhesives: effect of size distribution of conducting filler particles [J]. Mater Sci Semicond Process, 1999, 2: 263-269

降低 ZnO晶体中的载流子浓度,所以会降低样品的导电性能。 因此,退火温度偏低或偏高都会影响 ZAO的导电性能。

## 3 结 论

1) 采用 Sol-Gel工艺,在普通玻璃片上制得了 *c*轴择优取 向、高可见光透过率、高导电性的掺铝氧化锌透明导电薄膜。

2) 掺铝浓度对 ZAO薄膜的结晶取向和透射率都有一定的 影响。随着掺杂浓度的增加,衍射峰呈现出先增强后降低的趋势,晶粒度先增加后减小,半高宽也是先变窄后变宽。

3) 溶胶浓度对 ZAO 薄膜的表面形貌有较大的影响,浓度 增大时,其晶粒度呈增大的趋势。ZAO 薄膜的电阻率受退火温 度的影响,随着退火温度的升高,电阻率呈先减后增的趋势,可 达 8.0 ×10<sup>-4</sup> · · m。



- Polley T A, Carter W B, Poker D B, et al Deposited of zinc oxide thin films by combustion CVD [J]. Thin Solid Films, 1999, 357: 132-136
- [2] Rodrigo F, Maria E D, Zaniquelli A luminium-doped zinc oxide films prepared by an inorganic sol-gel route [J]. Thin Solid Films, 2004, 449: 86-93
- [3] Jin-Hong Lee, Byung-Ok Park Transparent conducting ZnO: Al, In and Sn thin films deposited by the sol-gel method [J]. Thin Solid Films, 2003, 426: 94-99
- [4] 赵九蓬,刘丽.新型功能材料设计与制备工艺[M].北京:化学工业 出版社,2003.34-35
- [5] Mohamed GA, Monhamed EA, ElfadlAA, et al Optical properties and surface morphology of Li-doped ZnO thin films deposited on different substrates by DC magnetron sputtering method [J]. Physical B, 2001, 308-310: 949-953
- [6] 陆峰,徐成海.透明导电 ZnO A1(ZAO)薄膜的性能分析 [J]. 真空 科学与技术,2003,23(1):75-78
- [7] 张德恒.透明导电薄膜中光吸收边的移动 [J]. 半导体杂志, 1998, 23 (3): 34-43
- [8] Tsubota T, Ohtaki M, Eguchi K, et al Thermoelectric properties of Aldoped ZnO as a promising oxide material for high temperature thermoelectric conversion [J]. J. Matter Chem., 1997, 7(1): 85-90
- [4] Sun M. Conductivity of conductive polymer for flip chip bonding and bga socket [J]. Microelectron J, 2001, 32: 197-203
- [5] LiL,Lizzul C, Kin H, et al Electrical, structural and processing properties of electrically conductive adhesives[J]. IEEE Transactions on Components, Hybrids, and Manufacturing Technology, 1993, 16(8): 843-851
- [6] Charles Guan Y, Han Kenneth N. An electrochemical study on the dissolution of copper and silver from silver copper alloys[J]. J. Electrochem. Soc., 1995, 142 (6): 1819-1825
- [7] 黄世强,肖汉文,黄应昌.特种胶粘剂 [M].北京:化学工业出版社, 2006.139-169